

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2025年年度科创板模拟芯片设计行业集体业绩说明会） <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参加单位名称	线上参加本次业绩说明会的投资者
日期/时间	2026年4月30日 15:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：卢国建先生 董事、副总经理：万巍先生 董事、财务总监：谭兰兰女士 董事会秘书：张娟苓女士 独立董事：余进华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请问如何看待行业未来的发展前景？</p> <p>公司回答：当前集成电路产业正处在多重新技术变量叠加交汇的历史性拐点。汽车电子、AI 终端和物联网是核心增长引擎。更为重要的是，中国半导体产业已进入从补短板到建长板的战略关键期。在这场变革中，芯海科技的战略定位十分关键。AI 赋能在消费电子、汽车和物联网等场景中的应用不断加深，行业对高精度测量、安全控制和实时感知芯片的需求正在井喷式增长。边缘 AI 设备正在重塑“云-边-端”协同的计算格局，边缘计算、汽车电子、BMS 等细分赛道均呈现出巨大的增长空间。芯海长期深耕的“模拟信号链+MCU”双平台技术，恰是 AI 与智能终端实现精准感知和高效管理的核心基座。展望未来，公司将进一步深化 AI 在端侧、边缘侧产品中的应用，持续突破车规级安全芯片等</p>

高壁垒领域，用坚实的科技创新与持续改善的业绩，推动公司在国产半导体产业升级的重要窗口期实现更大跃升。

二、请问贵司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

公司回答：公司未来盈利增长的核心驱动力主要来自三个方面：

1. 公司多节 BMS 芯片已在国内头部客户大批量出货，车规级 BMS AFE 获得国际功能安全认证；计算外围芯片生态中的 EC、PD、USB HUB 等产品全面导入全球主流笔电供应链。随着这些产品收入规模持续扩大，规模效应将逐步显现。

2. 国产替代与政策红利形成强劲的增量窗口。公司作为鸿蒙生态核心共建方，接入项目和终端出货量持续攀升，全面拉动感知、连接、控制类芯片的需求。同时，车规级 MCU、ADC 等产品已实现量产上车，首颗 ASIL-D 等级 MCU 成功回片，汽车电子业务正从战略投入期迈向收获期，成为第二增长曲线的核心引擎。

3. 在保持高强度研发投入的同时，公司将持续推进 IPD、LTC 等流程型组织变革，提升研发转化效率和运营效率，优化费用结构。随着收入规模的快速扩大和费用率的摊薄，盈利能力将稳步改善，实现高质量发展。

三、请问贵司本期财务报告中，盈利表现如何？

公司回答：2025 年，公司实现营业收入 8.5 亿元，较上年同期增长 20.82%；系前期战略投入新产品如系列化 BMS 芯片、智能穿戴 PPG 芯片及 USB-HUB 芯片进入快速上量阶段，叠加传统优势业务包括智能仪表、人机交互及低端消费类芯片需求回稳，出货保持稳定，推动公司整体营收实现增长，其中：模拟信号链芯片实现销售近 3 亿元，较上年增长 65.20%；MCU 和 AIoT 芯片实现销售超 5 亿元，较上年增长 2.91%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,544.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,509.20 万元，较上年同期亏损缩窄 6,696.27 万元，系受收入增长带来的规模效应、成本结构优化及效率提升综合因素影响，净利润亏损额较 2024 年大幅收窄。

附件清单
(如有)

/